株式会社レゾナック「技術ニーズ一覧」

H-01　計測・検査	
求める技術・機能	製品外観検査の高速・安価な自動化システム
背景・目的	製造工程での外観検査を高速かつ低コストで両立させたい。撮像（カメラ／レンズ／照明）、画像合成処理、通信、PC ベース検査処理、検査システム構成までを含む。
求める水準	高速性と低コストの両立。タクト・コストの具体目標は個別協議
想定する連携形態	共同開発／装置受託製作

H-02　計測・検査	
求める技術・機能	非平滑面の欠陥を安定的に撮像・顕在化する技術
背景・目的	製品表面の状態（地合い）の影響を受けずに欠陥を安定的に画像化したい。撮像・画像合成処理が中心。
求める水準	欠陥部と良品部の輝度比を一定以上確保
想定する連携形態	共同開発／技術評価

H-03　計測・検査	
求める技術・機能	フィルム膜厚方向のフィラ分布を定量評価する技術
背景・目的	フィルム製品の材料組成・塗工乾燥条件とフィラ分布の関係を体系化し、新製品開発期間を短縮したい。
求める水準	フィルム厚み数μm～数百μm、無機フィラ各種に対応
想定する連携形態	受託測定／共同評価

H-04　計測・検査	
求める技術・機能	多層膜の各層厚みを非破壊で評価する技術
背景・目的	多層構成フィルムの品質管理において、SEM 観察に代わる非破壊の簡易評価技術を求めている。 オフライン測定が必須、インライン測定が望ましい。
求める水準	層ごとに樹脂・フィラ組成が異なる多層膜に対応
想定する連携形態	受託測定／装置共同開発

H-05　計測・検査	
求める技術・機能	ロール to ロール工程での全面インライン膜厚測定技術
背景・目的	広幅・高速の塗工ラインで面内膜厚精度を管理したい。新製品の量産適用に必要な品質管理技術。
求める水準	広幅・高速ラインでの繰返し測定精度の確保
想定する連携形態	装置共同開発

H-06　精密加工	
求める技術・機能	材料特性評価・耐久試験用の精密治具の設計・製作
背景・目的	材料試験および搬送ラインにおける高精度な位置決め治具を必要としている。
求める水準	高精度な位置決め、試験条件に応じた個別設計
想定する連携形態	受託設計・製作

H-07　精密加工	
求める技術・機能	脆性材（ガラス・セラミック・シリコン等）の微細加工・穴あけ
背景・目的	先端パッケージング材料の試作評価において、基板等の精密微細加工を外部に委託したい。
求める水準	マイクロブラスト／レーザー／マシニング等、工法は問わない
想定する連携形態	加工受託／共同評価

H-08　表面処理	
求める技術・機能	カップリング剤処理以外の粒子表面処理・コーティング法
背景・目的	粒子の分散・樹脂複合化において、従来と異なる手法で耐熱性向上や絶縁性付与といった機能を付与したい。
求める水準	絶縁コーティング、耐熱性付与、新規機能付与
想定する連携形態	共同開発／受託処理

H-09　表面処理	
求める技術・機能	磁性粒子への耐酸性・耐アルカリ性・絶縁性コーティング
背景・目的	磁性粒子を各種プロセスに適用するため、粒子表面に耐薬品性と絶縁性を付与したい。
求める水準	プロセス耐性を有する均一コーティング
想定する連携形態	共同開発／受託処理

H-10　表面処理	
求める技術・機能	高耐久・高放熱・高絶縁の金属表面処理（アルマイト系等）
背景・目的	アルミ冷却部材・放熱ユニット、製造装置部品の高付加価値化を図りたい。
求める水準	高耐食性・高耐摩耗性と放熱／絶縁性の両立
想定する連携形態	受託処理／共同開発

H-11　粒子・粉体	
求める技術・機能	ナノ粒子の解砕・粉砕過程を調べる評価手法
背景・目的	ナノスケールの不定形粒子について、硬さだけでなく割れ方（分割数、割れた後の形状や分布）を把握したい。
求める水準	100㎚ 前後の不定形粒子に対応
想定する連携形態	受託測定／共同評価

H-12　粒子・粉体	
求める技術・機能	微粒粉砕の安定的かつ低コストな量産技術
背景・目的	電池材料等で、粒子形状・粒径の制御により粒子内・表面のイオン拡散速度を向上させたい。
求める水準	数㎛～数 ㎚ オーダーの安定粉砕
想定する連携形態	受託加工／共同開発

H-13　粒子・粉体	
求める技術・機能	粒子径が揃った微細はんだ粒子の製造および分級技術
背景・目的	微細接続材料向けに、粒度の揃ったはんだ微粒子を安定的に得たい。
求める水準	狭い粒度分布での量産分級
想定する連携形態	受託製造／共同開発

H-14　電源・電装	
求める技術・機能	高効率・高信頼性のカスタム電源モジュール
背景・目的	産業・医療分野向けの電源モジュールについて、当社の高放熱・絶縁電子材料を組み込んだ共同試作・評価を行いたい。
求める水準	用途に応じた個別設計、試作対応
想定する連携形態	共同試作・評価

H-15　モータ	
求める技術・機能	モータの解析および実装評価（効率・損失）技術
背景・目的	圧粉磁心を用いたモータについて、解析・設計と実装評価の方法を確立したい。協力メーカ・外部機関の獲得を含む。
求める水準	モータ効率の目標値は個別協議
想定する連携形態	共同評価／受託解析

H-16　モータ	
求める技術・機能	アキシャルギャップモータコアの樹脂モールドおよび巻線技術
背景・目的	モータコアへの樹脂モールドと巻線の方法を確立し、試作ラインを構築したい。
求める水準	試作ライン構築が可能な水準
想定する連携形態	受託試作／共同開発

H-17　成形・シール	
求める技術・機能	化学発泡剤の合成および発泡セルサイズの制御技術
背景・目的	射出成形品の緻密な発泡状態を形成し、強度・剛性を向上させたい。発泡技術の材料部分をノウハウ化したい。
求める水準	発泡セルサイズの微細化・均一制御、金型汚染なし、耐水性良好
想定する連携形態	共同開発

H-18　成形・シール	
求める技術・機能	過酷環境に耐える精密シール・断熱部材の設計・量産技術
背景・目的	次世代 EV バッテリー等、高耐熱・断熱・緩衝を同時に要求される部位向けの部材を共同開発したい。
求める水準	高耐熱・断熱・緩衝・難燃性の両立
想定する連携形態	共同開発／受託製造

H-19　工程・環境	
求める技術・機能	製造ラインにおける静電気・異物（コンタミ）対策技術
背景・目的	高純度材料の製造ライン・クリーンルームにおいて、静電気および微小異物の混入を抑制したい。
求める水準	高精度材料製造に耐えうる清浄度
想定する連携形態	装置導入／共同検証

H-20　工程・環境	
求める技術・機能	薬剤を用いない冷却水・循環水のスケール除去技術
背景・目的	製造工場の冷却水・循環水ラインにおいて、薬剤フリーでのスケール除去と省エネを実証したい。
求める水準	薬剤フリーでの除去効果と消費電力削減の実証
想定する連携形態	実証試験／共同検証

H-21　粒子・粉体	
求める技術・機能	微粒、粗粒の発生しない粉砕の量産技術
背景・目的	粉砕工程における微粉、粗粉のない成形材料を製造することで成形プロセスにおける粉体供給トラブルや成形品の品質向上につなげる。
求める水準	75μm 以下の微粉、2mm 以上の粗粉が発生しない安定した粉砕ができること
想定する連携形態	受託加工／共同開発